THEMI-CON 导电性高分子混合型铝电解电容器

导电性高分子混合型铝电解电容器焊接推荐条件

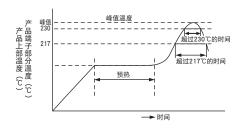
◆贴片型焊接推荐条件

使用锡膏,在玻璃环氧树脂基板($90^{L} \times 50^{W} \times 0.8^{L}$ mm, 带电阻)上进行焊接的时候,产品上部及端子部分温度,时间的推荐范围如下表所示。

回流次数不超过 2 次。第 1 次回流之后,必须确保电容器的温度已经完全冷却到室温 (5 \sim 35 $^{\circ}$) 后方可进行第 2 次回流。

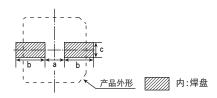
● 回流概要

焊接方法:空气回流法或红外线回流法



尺寸代码	预热		超过230℃ 的时间	峰值温度	回流次数
E61, F61, F80	150~180℃ ≦120秒	≦50秒	≦40秒	≦260° C	≦2次
HA0∼JH0		≦50秒	≦40秒	≦260°C	1次时
				≦245 ℃	2次时

● 推荐焊盘尺寸



[mm]											
	尺寸代码	端子代码: A			端子代码: G						
		а	b	С	а	b	С				
	E61	1.4	3.0	1.6							
	F61、F80	1.9	3.5	1.6	1.9	3.5	3.3				
	HA0	3.1	4.2	2.2	3.1	4.2	3.5				
	JAO _V JC5	4.5	4.4	2.2	4.5	4.4	3.5				
	JH0	4.0	4.7	2.5	4.0	4.7	3.8				

◆引线型波峰焊接推荐条件

● 波峰焊接条件

预热:150℃ 120秒Max

波峰焊:260+5℃ Max 10+1秒Max (或380±10℃ 3±0.5秒以下:手焊)

◆使用注意事项

1. 焊接方法

贴片型因用于回流焊,不适合于DIP焊接,请务必注意

2. 关于回流焊接

请采用上述焊接方法和在推荐条件下使用。此外,请注意即使是相同的设定条件,当以下设定条件不同时也会出现温度差。当条件不同于以上推荐条件时,请贵司确认电容器实际受到的温度应力之后与本公司进行探讨。

- ①产品的位置不同。(基板边缘部的温度上升高于基板中央部。)
- ②零件数量、安装密度不同。(零件数量越少,安装密度越低,温度上升越大。)
- ③使用基板种类不同。(同尺寸、厚度时,为了得到相同的基板温度,需要将陶瓷基板的温度设定得比玻璃环氧树脂基板低,但这样零件受到的应力变大。)
- ④基板的厚度不同。(基板越厚,和③同样,需要将炉内温度设定得越高。)
- ⑤基板的大小不同。(基板越大,和③同样,需要将炉内温度设定得越高。)
- ⑥焊剂厚度不同。(当焊接厚度非常薄时,请向我司咨询。)
- ⑦利用红外线进行焊接时,加热器的位置不同。(下部加热和电热板同样, 电容器的破损将减少。)
- ⑧随焊接条件变化的漏电流,可能会在焊接后增大(数 mA 左右)。此外,通过加载电压使用,漏电流会逐渐变小。
- ⑨关于汽相焊(Vapor Phase Soldering)的焊接方法,请另外与我们联系。

3 手动重焊

当出现错焊时请进行手动重焊。此时,请设定烙铁尖端温度为380±10℃、对电容器进行 3 ±0.5 秒以下的焊接。

4. 机械应力

焊接后,如果对电容器施加机械应力将可能导致异常发生,请务必注意。 请避免拿住电容器主体,按压电容器,翻转基板。

5. 粘着剂

建议利用粘着剂固定产品。关于粘着剂的选择请考虑以下各点。

- ①短时间内能低温硬化。
- ②粘着力强,硬化后耐热性能优良。
- ③开封后使用时间长。
- ④对产品无腐蚀性。

6. 基板清洗

请在容许条件下清洗。此外,为了使清洗液无残留,请在清洗后马上用 50~ 85℃的热风干燥10分钟以上。

7. 涂装

- ①安装后,在基板上涂装树脂时,为了减轻电容器受到的应力,建议涂上缓冲剂。(请使用无卤素类的涂层树脂。)
- ②涂装树脂时,请确认已经无清洗液残留后再进行树脂涂装。

8. 树脂封装

树脂中卤素离子多的时候,该成分有可能通过封口橡胶侵入到内部从而 导致异常发生,请务必注意。

9. 其他

· 八己 也请参照(导电性高分子混合型铝电解电容器)使用注意事项。